

台北市電腦公會 您好：

為推動產業參與審查期間第三方意見制度，協助企業於專利公開階段掌握相關資訊，避免潛在的專利侵權風險，本局將於每期專利公開日，寄送與貴公會專業技術領域相關之專利公開案件資訊供查閱參考，煩請協助將本郵件轉寄貴會會員。如您認為所寄送之發明專利申請案有應不予專利之情事，可向本局提交第三方意見作為本局審查參考，有關第三方意見提交方式及相關說明請參見[本局網站](#)。

專業技術領域：G06F-1/16、G06F-1/20、G11B

檢索條件：IC=G06F-1/16 or IC=G06F-1/20 or IC=G11B\*

傳送日期：20260203

公開日範圍：20260201

結果筆數：4 （如超過 1000 筆則以輸出 1000 筆為限）

本郵件資料僅供參考，所有資料以經濟部智慧財產局公告為準

如要檢視完整資料，請回 [檢索系統](#)

序號	專利編號	公開日	申請號	專利名稱
1	202606390	2026/02/01	114125425	配線電路基板及配線電路基板之製造方法
2	202605181	2026/02/01	114120906	磁性記錄媒體用濺鍍靶 SPUTTERING TARGET FOR MAGNETIC RECORDING MEDIA
3	202605200	2026/02/01	114119265	容器用金屬板、容器用金屬板的製造方法，及罐的製造方法
4	202605542	2026/02/01	113127321	具有固態硬碟的模組、多晶片模組及散熱方法 MODULE INCLUDING SOLID-STATE DRIVE, MULTI-CHIP MODULE, AND HEAT DISSIPATION METHOD